

防静电晶圆膜

◆ 产品描述

防静电晶圆膜是半导体行业中用于保护晶圆在生产、运输、储存及加工过程中免受静电损害与物理损伤的功能性薄膜材料，核心价值在于静电防护与晶圆表面洁净保护，是半导体产业链中不可或缺的关键辅助材料。

- 精准可控的防静电性能
- 高洁净低析出特性
- 优异的物理防护能力
- 强工艺适配性
- 稳定的环境适应性

◆ 产品结构

- 防静电晶圆膜采用多层复合结构设计，核心由基材层PE、防静电层及功能适配层构成，整体结构设计围绕静电防护、物理保护与工艺适配展开，满足晶圆生产、加工、仓储运输全流程的防护需求。

◆ 场景应用

- 防静电晶圆膜广泛用于半导体晶圆生产、加工、封装、仓储及运输全流程场景，在耐温耐湿的稳定性能可满足长途运输与长期仓储的防护需求，为晶圆提供全链路静电与物理防护。



◆ 产品数据和物理性能

材质：PE（聚乙烯）
胶层：丙烯酸酯压敏胶
纹路：钻石纹
厚度：0.1MM
直径：127MM
防静电阻值： $\leq 10E9\Omega$
拉伸强度： $\geq 20\text{MPa}$
断裂伸长率： $\geq 150\%$
剥离力：0.1~1.0N/25mm
包装规格：屏蔽袋包装

供应情况：

物料编码	直径	包装方式	重量
1.2.13.09.0056	127MM	200张/包	0.32kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。